

## BQ79712B-Q1 機能安全準拠の車載バッテリ モニター

### 1 特長

- 周囲温度範囲 -40 ~ +125°Cで AEC-Q100 認定済み
- **機能安全準拠**
  - ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
  - ASIL Dまでの決定論的対応能力
  - ASIL Dまでのハードウェア機能
- デバイスあたり直列 9~12 個のセルを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
- セルごとに専用の ADC
- 64us に同期したセル電圧およびバッテリ パック電流の測定
- 完全な冗長性を備えたリープ ホーム モードをサポート
- 構成可能なポスト ADC デジタルローパスフィルタを内蔵
- 測定精度に影響を与えずにバス バーをサポート
- 温度センサ/アナログ/デジタル/I<sup>2</sup>C コントローラ/SPI コントローラ用の 7 個の GPIO を搭載
- セル バランシングを内蔵
  - 200mA (BQ79712SB)、400mA (BQ79712PB) におけるバランシング
  - ユーザー制御 PWM 調整平衡化電流
  - 自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
- 堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
- POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシリケートするホスト制御のハードウェア リセット
- 変圧器と容量性絶縁をサポート
- ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
- シャットダウン電流 6uA
- SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換

### 2 アプリケーション

- ハイブリッドおよび電動パワートレイン システムのバッテリ管理システム (BMS)
- バッテリ管理システムを搭載したエネルギー貯蔵バッテリパック

### 3 説明

BQ79712SB-Q1 および BQ79712PB-Q1 は、xEV/EV の高電圧バッテリ管理システムで、12S のバッテリ モジュールの高精度セル電圧測定を実現します。この BQ797xx-Q1 ファミリは、さまざまなチャネル オプションを提供し、確立されたソフトウェアとハードウェアをあらゆるプラットフォームで再利用できます。このデバイスは、厳格な車載規格と安全要件を満たす高度な ADC アーキテクチャと測定システムを搭載しています。このデバイスは、トランジス (またはコンデンサ) で絶縁されたデイジー チェーンにより、xEV パワートレインの集中型または分散型アーキテクチャ用に設計されています。

#### パッケージ情報

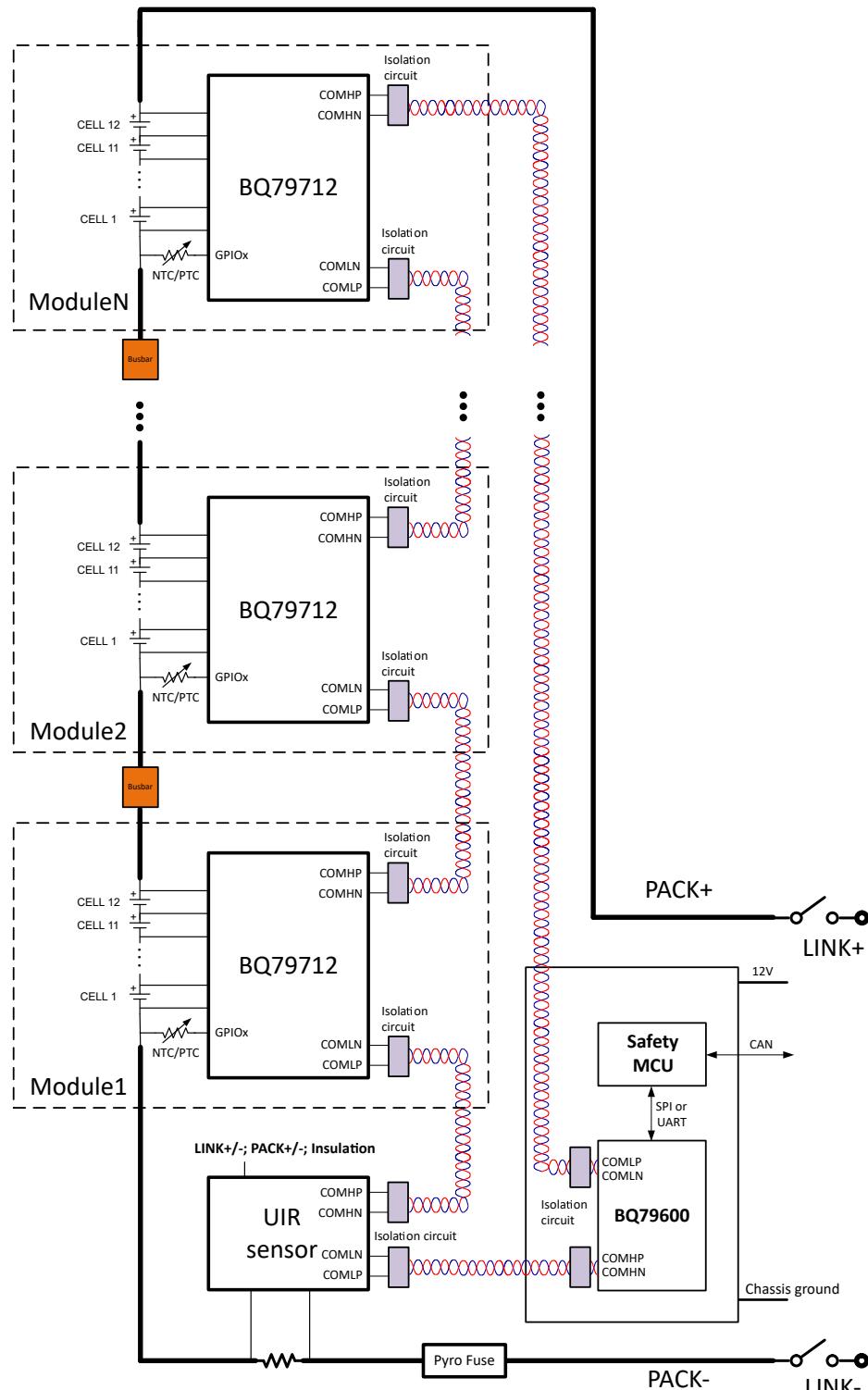
部品番号 <sup>(1)</sup>	パッケージ <sup>(2)</sup>	パッケージ サイズ <sup>(3)</sup>
BQ79712PB-Q1	HTQFP (48)	7.00mm × 7.00mm
BQ79712SB-Q1		

- (1) このデータシート内の図で BQ79712、BQ79712P、BQ79712S の言及は、それぞれ BQ79712B、BQ79712PB、BQ79712SB を参照してください。
- (2) 利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
- (3) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合も含めます。



このリソースの元の言語は英語です。翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

English Data Sheet: [SLVSKX6](#)



システム簡略図

## 4 デバイス比較表

デバイス	STATUS	説明
BQ79712PB-Q1	アクティブ	12S、7 本の GPIO、統合型 DCDC
BQ79712SB-Q1	アクティブ	12S、7 本の GPIO、内蔵 LDO FET

## 5 デバイスおよびドキュメントのサポート

### 5.1 デバイス サポート

#### 5.1.1 サードパーティ製品に関する免責事項

サードパーティ製品またはサービスに関するテキサス・インスツルメンツの出版物は、単独またはテキサス・インスツルメンツの製品、サービスと一緒に提供される場合に関係なく、サードパーティ製品またはサービスの適合性に関する是認、サードパーティ製品またはサービスの是認の表明を意味するものではありません。

### 5.2 ドキュメントのサポート

#### 5.2.1 関連資料

### 5.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、[www.tij.co.jp](http://www.tij.co.jp) のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

### 5.4 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計で必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

### 5.5 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.

すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

### 5.6 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことをお勧めします。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

### 5.7 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

## 6 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用している場合は、画面左側の説明をご覧ください。

## 6.1 付録：パッケージオプション

### パッケージ情報

発注可能なデバイス <sup>(1)</sup>	ステータス	パッケージタイプ	パッケージ図	ピン	パッケージの数量	エコ プラン <sup>(2)</sup>	リード / ボール仕上げ <sup>(5)</sup>	MSL ピーク温度 <sup>(3)</sup>	動作温度 (°C)	デバイスマークリング <sup>(4)</sup>
BQ79712PBQP HPRQ1	アクティブ	HTQFP	PHP	48	1000	RoHS & グリーン	NiPdAu	MSL-3-260C-16 8 HR	-40 ~ 125C	BQ79712PBQ
BQ79712SBQP HPRQ1	アクティブ	HTQFP	PHP	48	1000	RoHS & グリーン	NiPdAu	MSL-3-260C-16 8 HR	-40 ~ 125C	BQ79712SBQ

(1) マーケティング ステータスの値は次のように定義されています。

供給中:新しい設計への使用が推奨される量産デバイス。

最終受注中:TI はデバイスの生産終了を発表しており、現在最終受注期間中です。

非推奨品:新規設計には推奨しません。デバイスは既存の顧客をサポートするために生産されていますが、テキサス・インスツルメンツでは新規設計にこの部品を使用することを推奨していません。

量産開始前:量産されていない、市販されていない、またはウェブで発表されていない未発表デバイスで、サンプルは提供されていません。

レビュー:デバイスは発表済みですが、まだ生産は開始されていません。サンプルが提供される場合と提供されない場合があります。

生産中止品:TI は、このデバイスの生産を終りました。

(2) エコ プラン - 環境に配慮した計画的な分類:鉛フリー (RoHS)、鉛フリー (RoHS 適用除外)、またはグリーン (RoHS 準拠、Sb/Br 非含有) があります。最新情報、および製品内容の詳細については、<http://www.ti.com/productcontent> でご確認ください。

未定:鉛フリー / グリーン転換プランが策定されていません。

鉛フリー (RoHS):テキサス・インスツルメンツにおける「Lead-Free」または「Pb-Free」(鉛フリー) は、6 つの物質すべてに対して現在の RoHS 要件を満たしている半導体製品を意味します。これには、同種の材質内で鉛の重量が 0.1% を超えないという要件も含まれます。高温はんだに対応した テキサス・インスツルメンツ鉛フリー製品は、鉛フリー仕様プロセスでの使用に適しています。

鉛フリー (RoHS 適用除外):この部品は、1) ダイとパッケージとの間に鉛ベース フリップ チップのはんだバング使用、または 2) ダイとリードフレームとの間に鉛ベースの接着剤を使用、のいずれかについて、RoHS が免除されています。この部品はそれ以外の点では、上記の定義の鉛フリー (RoHS 準拠) の条件を満たしています。

グリーン (RoHS および Sb/Br 非含有):テキサス・インスツルメンツにおける「グリーン」は、鉛フリー (RoHS 準拠) に加えて、臭素 (Br) およびアンチモン (Sb) をベースとした難燃材を含まない (均質な材質中の Br または Sb 重量が 0.1%を超えない)ことを意味しています。

(3) MSL、ピーク温度 -- JEDEC 業界標準分類に従った耐湿性レベル、およびピークはんだ温度です。

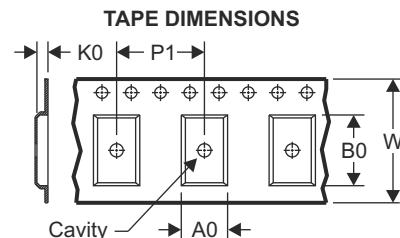
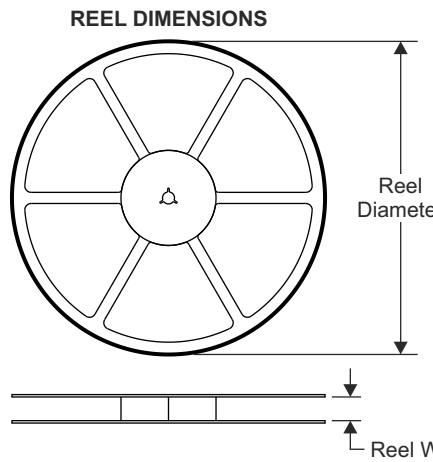
(4) ロゴ、ロットトレースコード情報、または環境カテゴリに関する追加マークがデバイスに表示されることがあります。

(5) リード / ボール仕上げ - 発注可能なデバイスには、複数の材料仕上げオプションが用意されていることがあります。複数の仕上げオプションは、縦罫線で区切られています。リード / ボール仕上げの値が最大列幅に収まらない場合は、2 行にまたがります。

**重要なお知らせと免責事項:**このページに掲載されている情報は、発行日現在のテキサス・インスツルメンツの知識および見解を示すものです。テキサス・インスツルメンツの知識および見解は、第三者によって提供された情報に基づいており、そのような情報の正確性について何らの表明および保証も行うものではありません。第三者からの情報をより良く統合するための努力は続けております。テキサス・インスツルメンツでは、事実を適切に表す正確な情報を提供すべく妥当な手順を踏み、引き続きそれを継続してゆきますが、受け入れる部材および化学物質に対して破壊試験や化学分析は実行していない場合があります。テキサス・インスツルメンツおよび テキサス・インスツルメンツのサプライヤは、特定の情報を機密情報として扱っているため、CAS 番号やその他の制限された情報が公開されない場合があります。

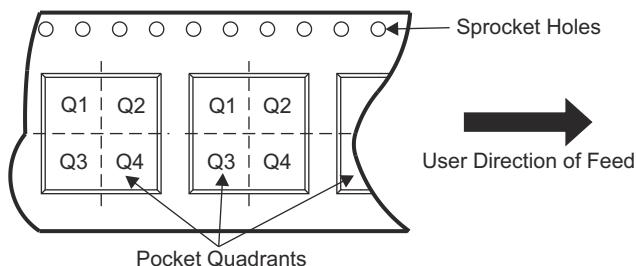
いかなる場合においても、そのような情報から生じた TI の責任は、このドキュメント発行時点での TI 製品の価格に基づく TI からお客様への合計購入価格 (年次ベース) を超えることはありません。

## 6.2 テープおよびリール情報



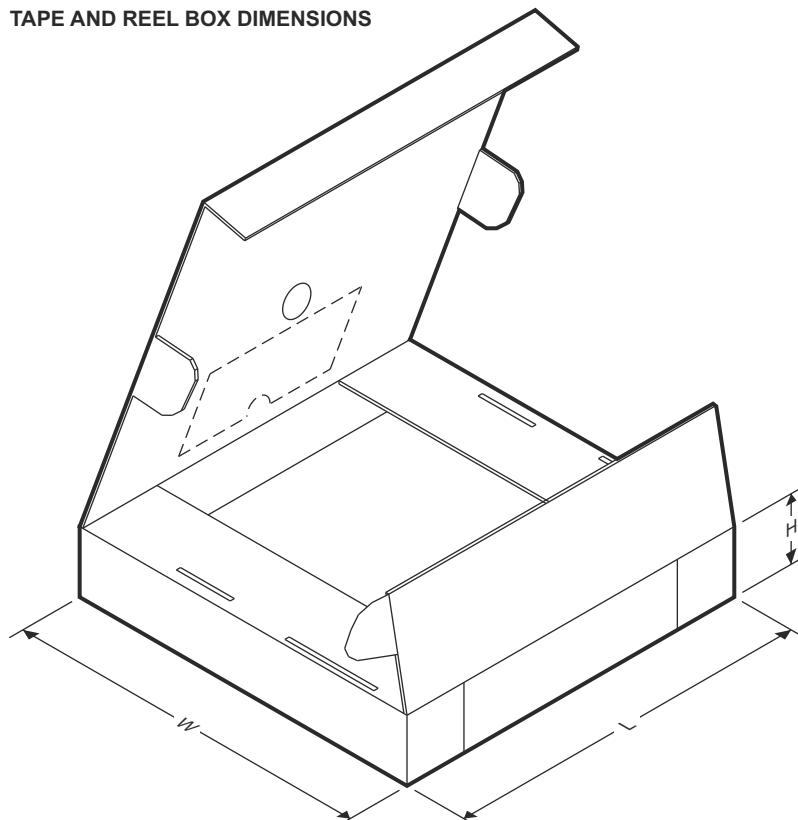
A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



デバイス	パッケージ タイプ	パッケージ 図	ピン	SPQ	リール 直径 (mm)	リール 幅 W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	ピン 1 の 象限
BQ79712PBQPHPRQ1	HTQFP	PHP	48	1000	330.0	16.4	9.6	9.6	1.5	12.0	16.0	Q2
BQ79712SBQPHPRQ1	HTQFP	PHP	48	1000	330.0	16.4	9.6	9.6	1.5	12.0	16.0	Q2

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



デバイス	パッケージタイプ	パッケージ図	ピン	SPQ	長さ (mm)	幅 (mm)	高さ (mm)
BQ79712PBQPHPRQ1	HTQFP	PHP	48	1000	336.6	336.6	31.8
BQ79712SBQPHPRQ1	HTQFP	PHP	48	1000	336.6	336.6	31.8

## 6.3 メカニカル データ

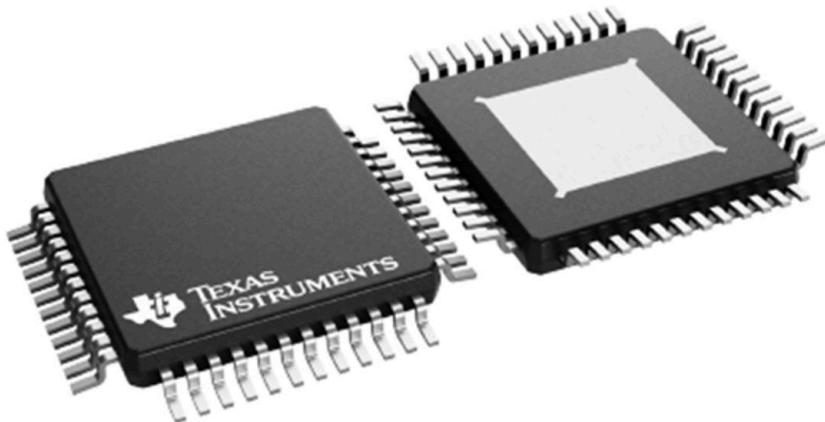
**PHP 48**

7 x 7, 0.5 mm pitch

**TQFP - 1.2 mm max height**

QUAD FLATPACK

This image is a representation of the package family, actual package may vary.  
Refer to the product data sheet for package details.

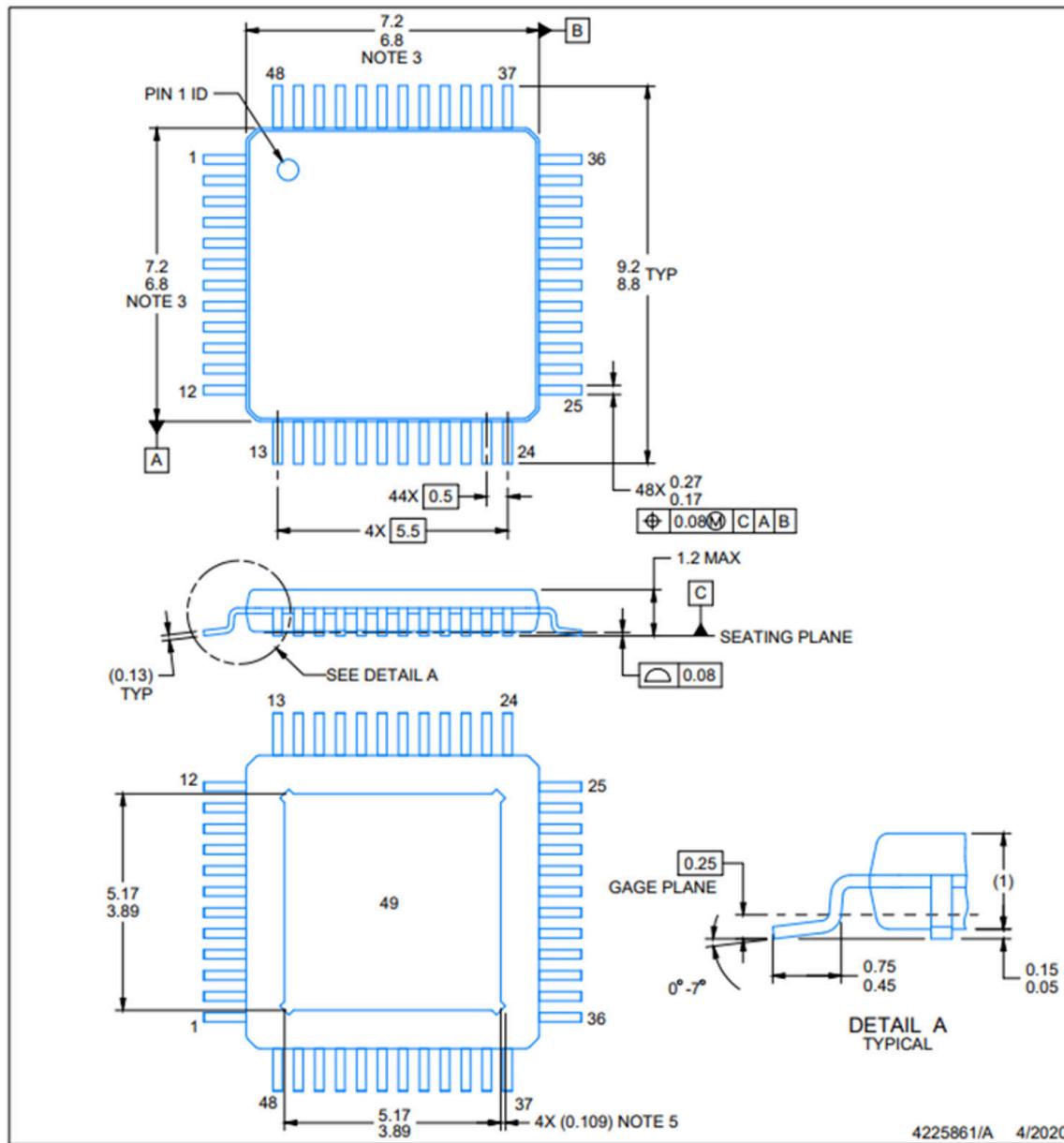


## PACKAGE OUTLINE

**PHP0048G**

**PowerPAD™ HTQFP - 1.2 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK



NOTES:

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

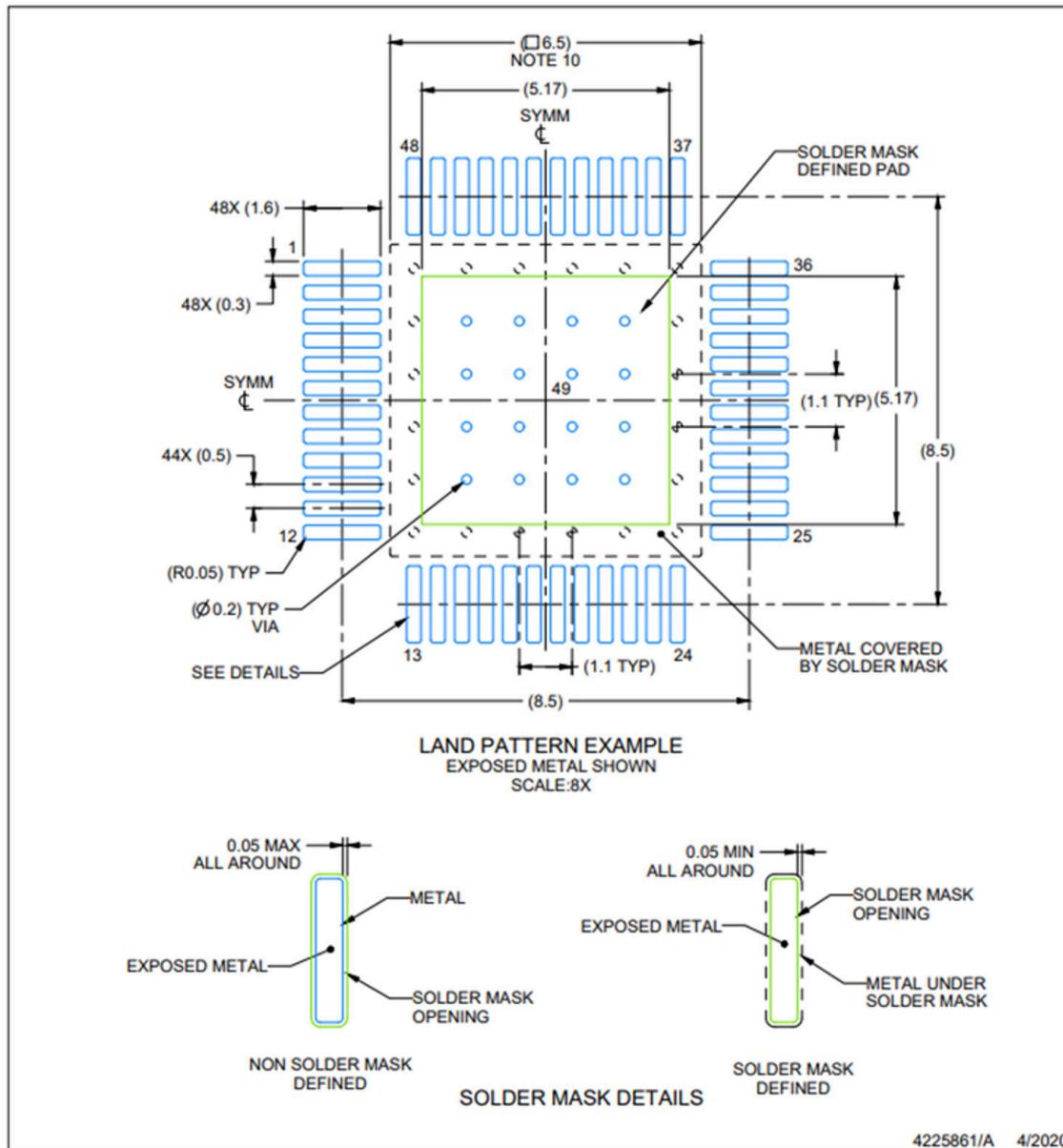
1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. Reference JEDEC registration MS-026.
5. Feature may not be present.

## EXAMPLE BOARD LAYOUT

**PHP0048G**

**PowerPAD™ HTQFP - 1.2 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK



4225861/A 4/2020

NOTES: (continued)

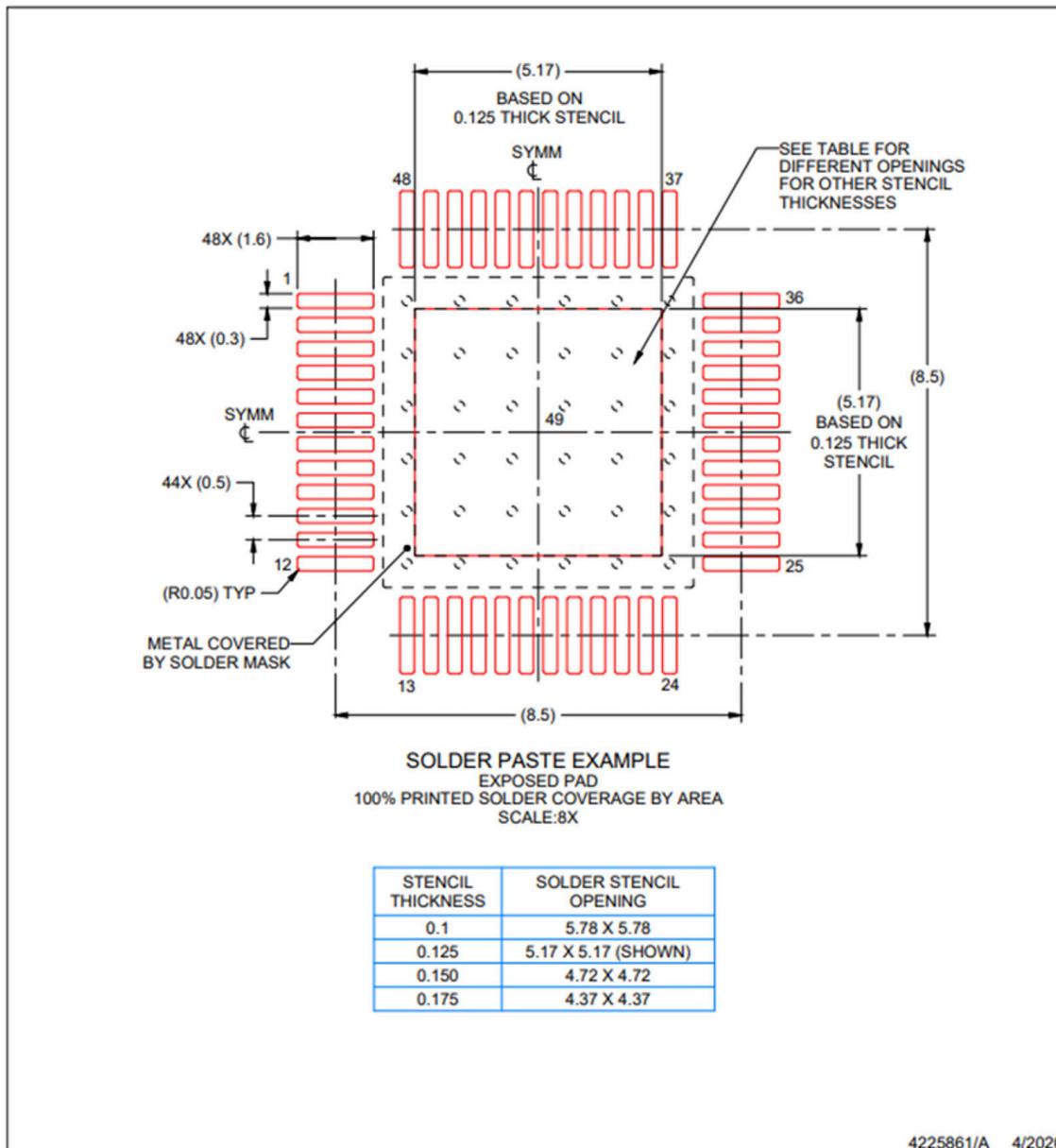
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
8. This package is designed to be soldered to a thermal pad on the board. See technical brief, Powerpad thermally enhanced package, Texas Instruments Literature No. SLMA002 ([www.ti.com/lit/slma002](http://www.ti.com/lit/slma002)) and SLMA004 ([www.ti.com/lit/slma004](http://www.ti.com/lit/slma004)).
9. Vias are optional depending on application, refer to device data sheet. It is recommended that vias under paste be filled, plugged or tented.
10. Size of metal pad may vary due to creepage requirement.

## EXAMPLE STENCIL DESIGN

**PHP0048G**

**PowerPAD™ HTQFP - 1.2 mm max height**

PLASTIC QUAD FLATPACK



4225861/A 4/2020

NOTES: (continued)

11. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
12. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

## 重要なお知らせと免責事項

TIは、技術データと信頼性データ(データシートを含みます)、設計リソース(リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Webツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の默示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または默示的にかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したもので、(1)お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2)お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3)お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日：2025 年 10 月